

Mechanik in neuen Dimensionen

Präzise und schnell: Hochgeschwindigkeitsfräsen mit bis zu fünf Achsen für komplexe Formgebungen

Um die steigende Nachfrage nach komplexen Gerätelösungen bedienen zu können, haben wir die mechanische Fertigung um eine weitere HSC-Fräse vom Typ DATRON erweitert. Die neue M10 erlaubt ein Fräsen in fünf Achsen und erfüllt damit ganz individuelle Anforderungen. Komplexe Formen lassen sich so in kürzester Zeit absolut präzise bearbeiten und fertigen.

Ob Vollmaterial oder spezielle Platten, mit der neuen Technologie erhalten Sie CNC-Frästeile nach Maß.

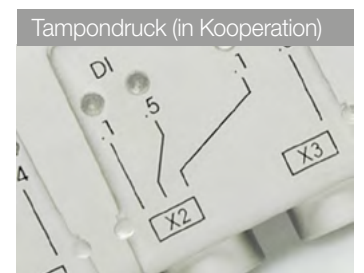
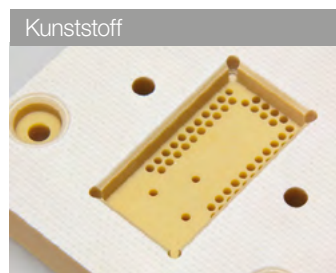
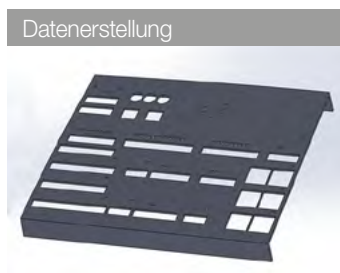
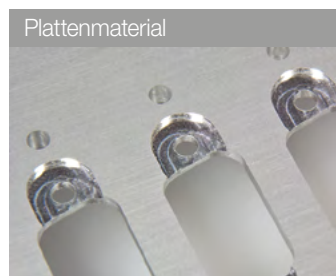
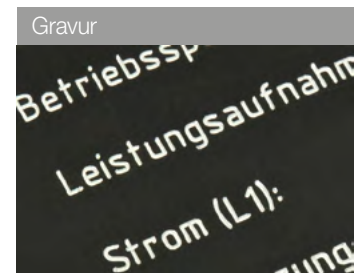


Leistungsspektrum

Von der Programmerstellung bis zum fertigen Gehäuse bieten wir diese Leistungen jetzt auch als eigenständigen Service an.

- Datenvorbereitung und Erstellung Ihrer 2½D und 3D CAD / CAM-Dateien
- Datenverarbeitung für die Austauschformate dxf, dwg, acis, step, sldprt (SolidWorks)
- Software: SolidWorks, SolidCAM, AutoCAD, PrimCAM

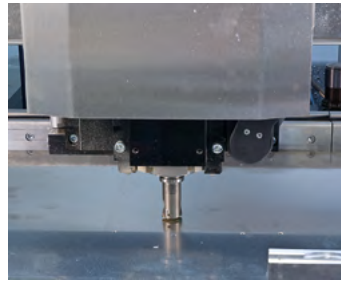
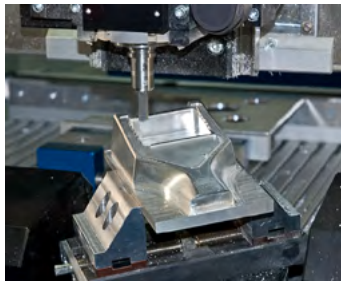
- Technologien: Fräsen, Bohren, Gewindschneiden, Gravieren
- Bauteilfertigung für komplette Gehäuse und Frontplatten
- Material: alle Nichteisenmetalle und Kunststoffe
- Fertigungskapazität: Prototypen bis zu mittleren Serien bis max. 500 Stück



	HSC Fräsmaschine M7	HSC Fräsmaschine M10 Pro
maximale Bearbeitungsgröße	500 x 500 x 240 mm	1.000 x 700 x 300 mm
Achsen	3	5
Genauigkeit	5 µm	5 µm
Werkzeugeinsatz	0,2 bis 12 mm	0,2 bis 20 mm
Drehzahl der Spindel	60.000 Umdrehungen / Minute	40.000 Umdrehungen / Minute
Besonderheiten	- Vakuumpalte 500 x 500 mm - 15-fach Werkzeugwechsler	- Drehschwenkachse und Nullpunktspannsystem für 5-Seitenbearbeitung - 22-fach Werkzeugwechsler
Kühlsystem	Ethanol	
Besonderheiten	- 3D-Taster zum Antasten der Werkstücke - Laser und mechanische Werkzeugvermessung	



HSC Fräsmaschine DATRON M10 Pro

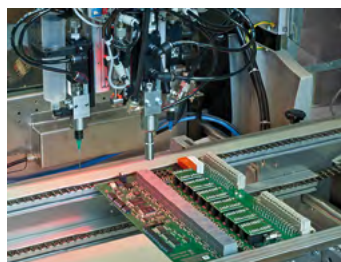


DATRON M7

Elektronikfertigung

Kapazitätserweiterungen durch neue Technik

Automatisierung der Prozesse selektive Lackierung und Leiterplattenreinigung



Selektives Lackieren mit der DIMA HC-200

Schutzbeschichtungen erhöhen die Qualität und Langlebigkeit von Leiterplatten. Vor allem unter rauen Bedingungen (z.B. Automotive) verlängert eine selektive Lackierung oder Verguss die Lebensdauer Ihrer Platinen erheblich. Unser neues vollautomatisches Inline-System mit einem 4-Achsenroboter sorgt dabei für höchste Präzision.

- maximale Baugruppengröße: 355 x 600 mm
- drei Ventile (Sprüh- und zwei Nadelventile, u.a. für „Dam and Fill“) für den Einsatz von zwei verschiedenen Medien (z.B. Lack und Gel) in einem Arbeitsgang
- Konturbreiten ab 2 mm realisierbar
- Standardmaterialien: Schutzlack ELPEGUARD SL 1307 FLZ/2 und für Lack/Verguss ELPEGUARD SL 1307 FLZ-T („Dam and Fill“)
- optimale Prozesssicherheit durch elektronische Druck- sowie Durchflusskontrolle
- höchste Präzision durch integrierte Referenzmarkenerkennung
- sichere Qualität durch Kontrolle der Baugruppen unter UV-Licht

Baugruppenreinigungsanlage Kolb PSB500

Die Baugruppenreinigung ist ein wichtiger Prozessschritt vor dem Lackieren oder Vergießen von Baugruppen. Mit der neuen Anlage werden Verunreinigungen durch Flussmittelrückstände und andere Hilfsstoffe effizient beseitigt.

- höchstmögliche Prozesssicherheit durch vollautomatischen Ablauf, automatische Nachdosierung des Reinigungsmediums und permanente Messung der Restkontamination (Leitwertmessung)
- schonendes Reinigen der Baugruppen durch Sprühverfahren mit asynchronen Rotoren – kein Ultraschall
- sehr gute Bauteilverträglichkeit durch den Einsatz von Reinigungsmedien auf Basis von Wasser
- sicheres Trocknen der Baugruppen durch Umluft mit variablen Temperaturen und Trockenzeiten
- Kapazität: bis zu 150 Leiterplatten im Euroformat (100 x 160 mm) pro Waschzyklus



Kontakt

dresden elektronik
ingenieurtechnik gmbh
Enno-Heidebroek-Straße 12
01237 Dresden

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Lutz Pietschmann

Tel. +49 351 31850-0
Fax +49 351 31850-10



info@dresden-elektronik.de
www.dresden-elektronik.de